

## ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

### MÍSTO KONÁNÍ:

Střední škola informatiky, Čichnova 23, 624 00 Brno

### SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystrc, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystrc, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystrc (přehrada), před prodejnou OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnu OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SŠ informatiky s možností parkování.

### ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete **poštou** nebo **e-mailem** spolu se závazným požadavkem na stravu, nejpozději do **12. 10. 2017** na adresu: **SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno**  
**e-mail: [smtinfo@nexta.cz](mailto:smtinfo@nexta.cz) do 12. 10. 2017**

### UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**.

Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

#### Ubytování na Střední škole informatiky Čichnova 23, Brno-Komín

**Cena ubytování / osobu / noc** 460,- Kč  
**(snídaně)** 50,- Kč

Telefonické objednávky: p. Hanáková, p. Kneslová  
**00420-541 123 364**

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

**Stravování:** oběd v areálu SŠ informatiky á 80,- Kč

**Prezence:** 17. 10. 2017 10.30 – 11.00 hod.  
18. 10. 2017 8.30 – 8.45 hod.

#### Účastnický poplatek včetně občerstvení a bulletinu

(úhrada při prezenci)

17. – 18. 10. 2017 (poplatek za 2 dny) 750,- Kč  
17. nebo 18. 10. 2017 (poplatek za 1 den) 500,- Kč

## SMT-INFO KONSORCIUM

ve spolupráci s

**FEKT VUT v Brně**

a

**SŠ INFORMATIKY BRNO**

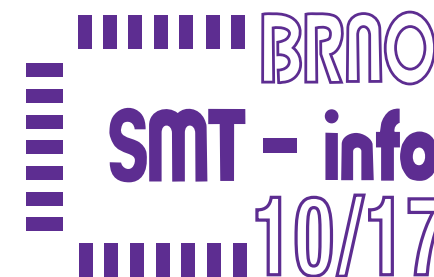
Vás zvou

na mezinárodní konferenci



Na společné posezení s občerstvením a diskusí Vás zve  
SMT-INFO konsorcium

Mediálním partnerem konference je odborný časopis  
DPS ELEKTRONIKA od A do Z



## PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

**ČIŠTĚNÍ DPS**

**NOVINKY**

**V MIKROELEKTRONICE**

**VADY PÁJENÉHO SPOJE**

**BRNO 17. – 18. října 2017**

**SŠ informatiky**

**Čichnova 23, Brno-Komín**

**kód akce 10/17**

## ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

## ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem
- V přílehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

ABETEC

ACC – SILICONES

ADOPT

AIM SOLDER EUROPE

AMTEST

INTERCONTI, KISSEL + WOLF

KEYENCE

KYZEN

MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE

PAN ELECTRONICS

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

## TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKČÍ

### POŘÁDANÝCH SMT-INFO:

**SMT-INFO 02/2018**

**6. února 2018**

**Místo konání: SŠ informatiky, Čichnova 23, Brno**

- NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS
- VÝROBA A VADY DPS
- KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY MODERNÍCH MONTÁŽÍ
- INSPEKČNÍ SYSTÉMY

## ODBORNÝ GARANT:

**SMT-INFO KONSORCIUM, Údolní 53, 602 00 Brno**

**tel.: 00420-541 146 113**

**mobil: 00420-602 542 966**

**e-mail: [smtinfo@nexta.cz](mailto:smtinfo@nexta.cz)**

## PROGRAM KONFERENCE

### Úterý – 17. října 2017

- 11.10 - Zahájení konference, úvod
- 11.20 - Nové pájecí pasty firmy ALPHA ASSEMBLY  
/N. Suli, ALPHA Hungary,  
M. Cichra, ERMEG Liberec/
- 12.00 - Precizní čištění DPS pomocí ekologické chemie  
/P. Kadleček, 3M Praha,  
M. Víšek, JAMI ELECTRONICS Praha/
- 12.40 - Vývoj bezolovnaté pájecí pasty s nízkým výskytem  
voidů pro vysoce spolehlivé aplikace  
/M. Mahon, INVENTEC Francie,  
M. Víšek, JAMI ELECTRONICS Praha/
- 13.20 - Oběd
- 14.00 - Požadavky na redukci podlahové plochy  
u tepelných procesů > 20 min.  
(vytvzování, sušení aj.)  
/D. Hayn, CERACON Weikersheim/
- 14.20 - Evoluce a vývoj vysoce spolehlivých  
bezolovnatých slitin  
/P. Bettinec, AIM SOLDER EUROPE Lodz/
- 14.40 - KYZEN chemie na čištění DPS  
/J. Vielhaber, KYZEN,  
J. Nunhart, MAROX Bratislava/
- 15.10 - Novinky u firmy Qualitek – pájecí materiály  
G. Freeman, QUALITEK,  
L. Pokorný, AMTEST GROUP Brno/
- 15.30 - Údržbové mytí, mytí silikonů a použité technologie  
/T. Ševčík, DCT Czech Černá Hora/
- 15.50 - Káva
- 16.10 - Proces pod kontrolou – Čištění DPS s chemií  
firmy ZESTRON  
/M. Šaffer, PBT Rožnov p. Radh./
- 16.30 - Optimalizace kvality a kapacity čištění  
na strojích PBT Works  
/V. Sítko, PBT WORKS Rožnov p. Radh./
- 16.50 - PROCES ČIŠTĚNÍ - můj denní byznys!  
/R. Ruhfass, KISSEL + WOLF,  
L. Novotná, T. Bravený, INTERCONTI Brno/
- 17.10 - Diskuse, zakončení 1. dne konference

**17.30–21.00 hod. Občerstvení spojené s diskusí  
Přátelské setkání účastníků konference a přednášejících**

**Na společné posezení s občerstvením a diskusí Vás zve  
SMT-INFO konsorcium**

### Středa – 18. října 2017

- 8.45 - Zahájení 2. dne konference
- 8.50 - Problematika iontové migrace  
/K. Dušek, FEL ČVUT Praha/
- 9.10 - Hodnocení účelnosti I/O modifikace otvorů  
šablony na redukci BTC voidů  
/A. Sedlák, AIM Solder Europe Lodz/
- 9.30 - Energeticky efektivní reflow pájecí systémy  
/A. Stemmler, SMT Maschinen und Vertriebs  
Wertheim, M. Galajda, SMT Service Košice/
- 9.50 - Káva, občerstvení
- 10.10 - Praktické zkušenosti s pájením ve vakuu  
/M. Hurban, REHM Česká republika Příbor/
- 10.30 - SAKI - 3D inspekce ve výrobním procesu  
/M. Kostadinov - SAKI/AMTECH/
- 11.10 - Kombinovaný systém pájecí vlny a selektivního  
pájení /M. Berberich, ATF Collenberg,  
M. Abel, ABETEC Pardubice/
- 11.30 - Trendy v opravárenských technikách a porovnání  
IR a HOT AIR metod - Low cost systémy  
fy HAKKO a TERMOPRO  
/M. Abel, ABETEC Pardubice/
- 12.00 - Diskuse
- 12.10 - Základní vlastnosti tepelně vodivých  
silikonových materiálů  
/R. Příkryl, ACC – SILICONES Brno/
- 12.30 - Vysoce kvalitní vysoušecí kabinety z Čech  
/D. Pospíšil, J. Procházka,  
MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE Blansko/
- 12.50 - Novinky u firmy Humiseal – materiály  
pro selektivní lakování a zalévání  
/B. Györfy, HUMISEAL,  
J. Vondráček, AMTEST GROUP Brno/
- 13.10 - Vady DPS – Vodivá anodická vlákna (CAF)  
(IEC 61189-5-503, IEC 62866, ISO 9455-17)  
/K. Jurák, Z. Nejezchlebová, ÚNMZ Praha/
- 13.30 - Zakončení konference
- 13.40 - Oběd

**Přednášky v angličtině a němčině budou tlumočeny.  
Změny programu vyhrazeny.**

Závazná přihláška na konferenci

**PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY  
ČIŠTĚNÍ DPS  
NOVINKY V MIKROELEKTRONICE  
VADY PÁJENÉHO SPOJE**

**17.–18. října 2017**

Jméno a příjmení, titul .....

.....

Název a adresa podniku (PSC) .....

.....

funkce v zaměstnání .....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

**Společenský večer:** 17. října 2017 **ano-ne**

**Stravování – oběd:** 17. října 2017 **ano-ne**

18. října 2017 **ano-ne**

.....

podpis účastníka

.....

razítko a podpis  
organizace

**ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2018**

**SMTinfo 02/18** **ano-ne**

Návrhové systémy DPS, výroba a vady DPS, komplexní  
výrobní linky, tiskové a osazovací stroje, inspekční systémy

**SMTinfo 10/18** **ano-ne**

Pájení a tepelné procesy, opravy v SMT, čištění DPS,  
trendy v mikroelektronice, defekty pájených spojů

Jméno a příjmení, titul .....

.....

e-mail .....

Název a adresa podniku (PSC) .....

.....

SMT-INFO konsorcium  
Údolní 53  
602 00 BRNO  
Czech Republic